

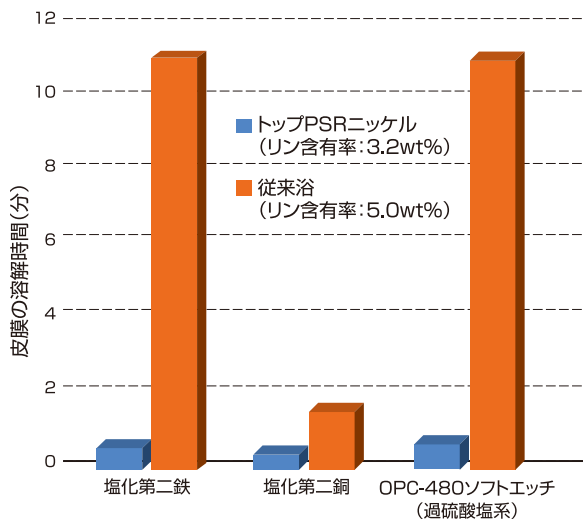
FO-PLP対応感光性樹脂への ニッケルシード層形成プロセス

トップPSRプロセス

- 全工程湿式プロセスでメタライズ可能
- FO-PLPに適したニッケルシード層形成プロセス
- ニッケルシード層のエッチング性に優れ、ファインパターン形成が可能
- 優れた密着性を有する

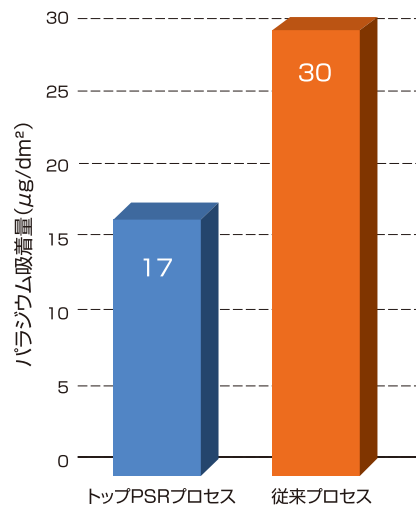
優れたファインパターン性

シード層エッチング性に優れる



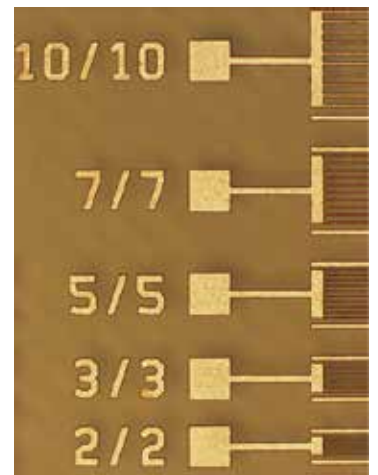
トップPSRニッケルの
皮膜中リン含有率と皮膜溶解性

ニッケル/金めっき時のパターン性に優れる



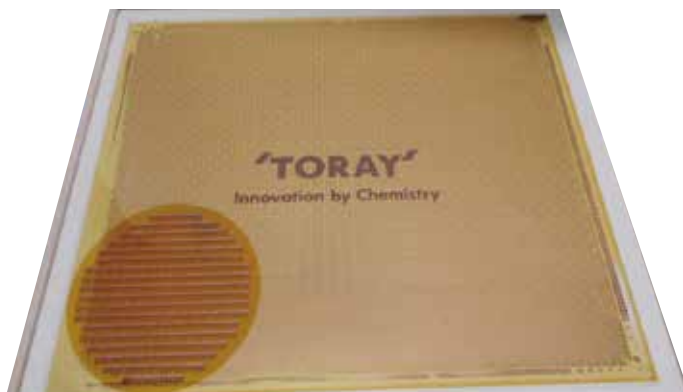
パラジウム吸着量の比較

パラジウム吸着量が少ない

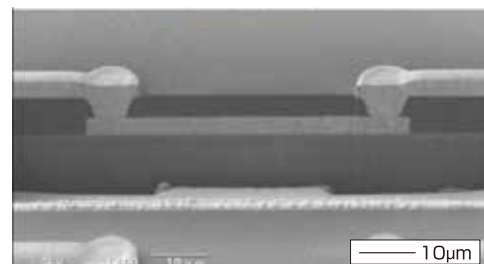


パターン作成例

FO-PLP: 絶縁膜層/配線層形成パネル (東レ株式会社様ご提供)



シード層形成: トップPSRプロセス



FIB-SEM像

ビア径: 5μm

全湿式プロセスで超微細配線形成を可能にします